



Aug. 19, 2015

TAIEX : 8070

CWE Commit to Total Excellence

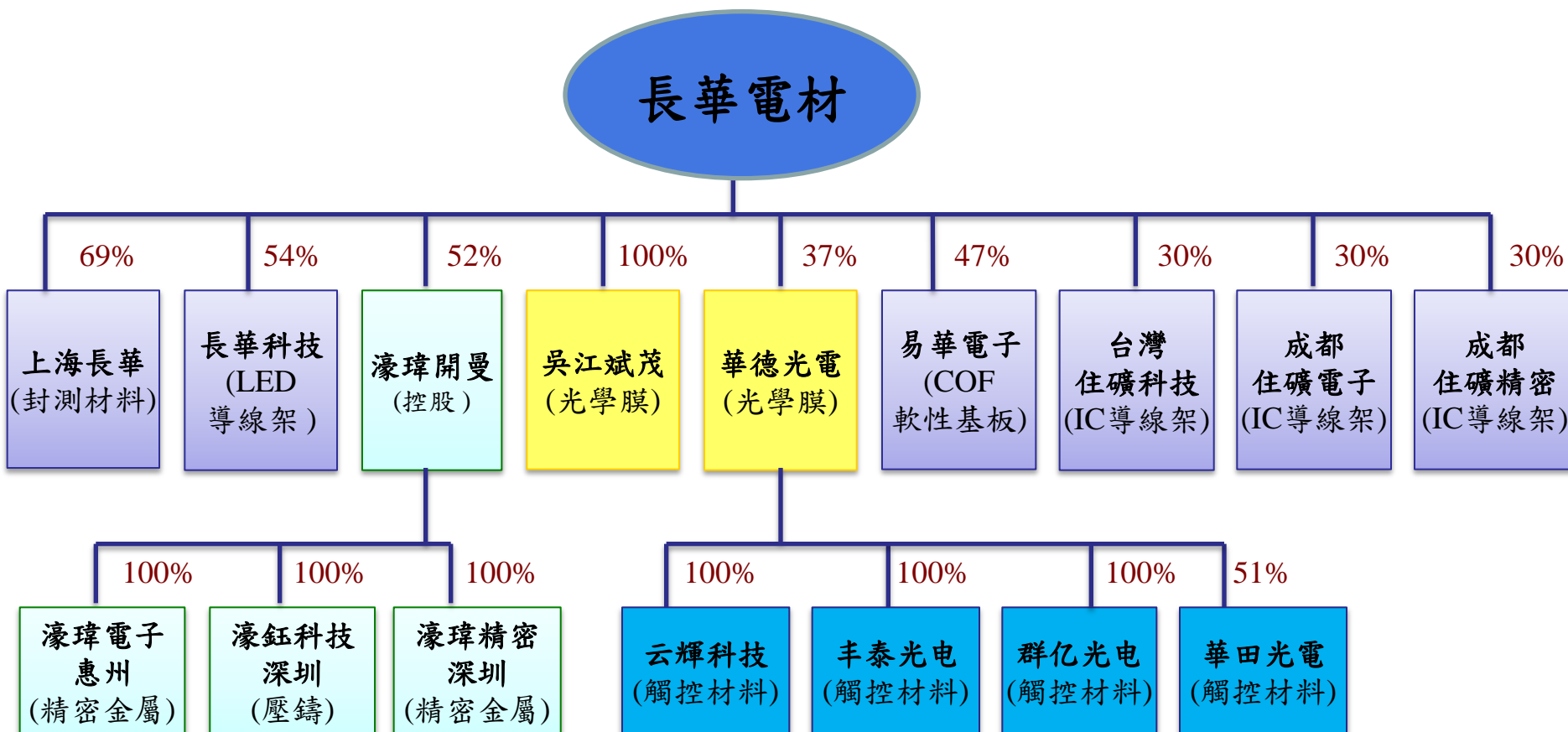
大綱

- 一、公司簡介
- 二、2015年2Q營運績效
- 三、主要轉投資公司概況
- 四、實施庫藏股買回
- 五、中長期發展願景
- 六、Q&A

一、公司簡介

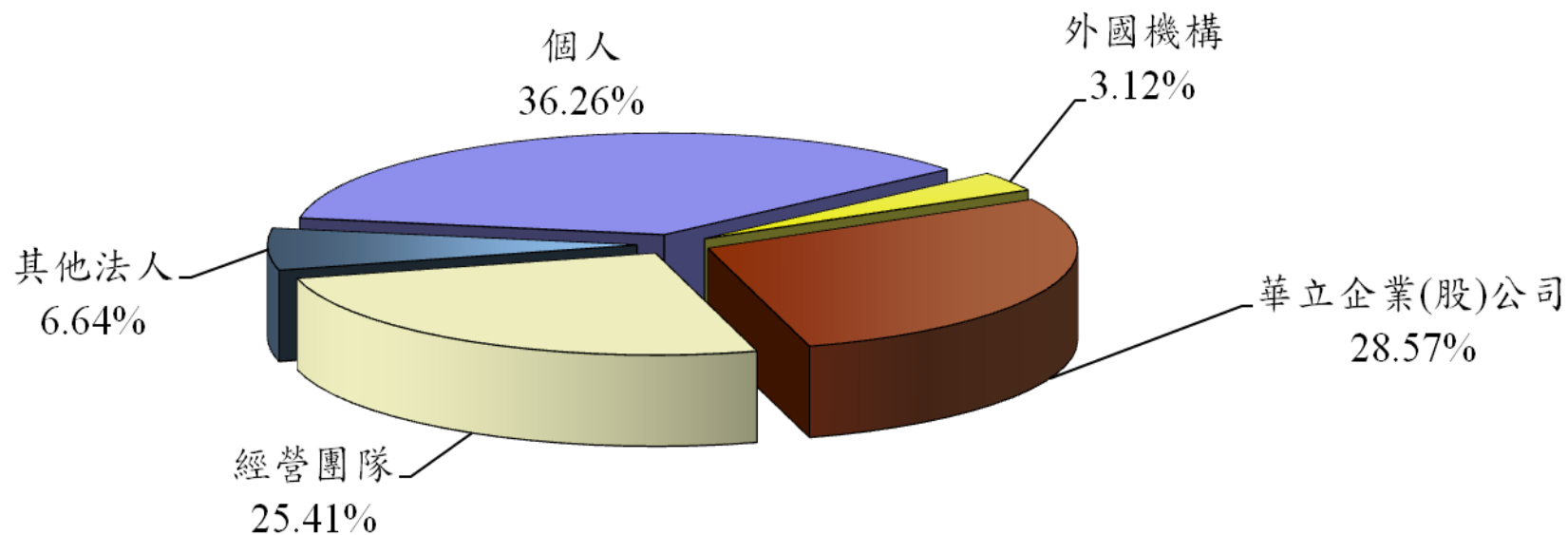
設立日期	1989年5月13日
董事長	黃嘉能
總經理	葉錕溢
實收資本額	新台幣7.69億元
員工人數	82人(單一) 3,524人(合併)
總公司地址	高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓

轉投資架構圖



產業類別	被投資公司名稱	主要產品	持股比率
IC封裝 材料與設備	易華電子(股)公司	COF軟性基板	47%
	長華科技(股)公司	LED導線架	54%
	台灣住礦科技(股)公司	IC導線架	30%
	成都住礦電子有限公司	IC導線架(電鍍)	30%
	成都住礦精密製造有限公司	IC導線架(沖壓)	30%
	上海長華新技電材有限公司	IC封裝材料、設備代理	69%
TFT背光 模組材料	華德光電材料科技(股)公司	光學膜(BEF、MBEF、MICROLENS)	37%
	吳江斌茂光電有限公司	光學膜裁切	100%
觸控面板 材料	豐泰光電(深圳)有限公司	觸控材料裁切	37%
	群億光電(深圳)有限公司		37%
	華田光電(成都)有限公司		19%
	云輝科技(股)公司	觸控材料代理	37%
3C產品 材料	濠瑋(深圳)精密科技有限公司	消費性產品及金屬零組件(端子、天線、彈片等)	52%
	濠瑋電子科技(惠州)有限公司		52%
	濠鈺科技(深圳)有限公司	汽機車配件及電子電器配件壓鑄	52%

股東結構(2015.06.09)



歷年獲利及股利政策

新台幣：元	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
稅後EPS	7.06	14.00	0.29	9.34	5.89	5.29
股票股利	0	0.30	0.29	0.30	0.00	0.00
現金股利	6	9.70	0.60	3.00	3.10	3.50
合計股利	6	10.00	0.89	3.30	3.10	3.50
股利發放率	85%	71%	307%	35%	53%	66%

二、2015年2Q營運績效

2015年第二季營運績效(合併)

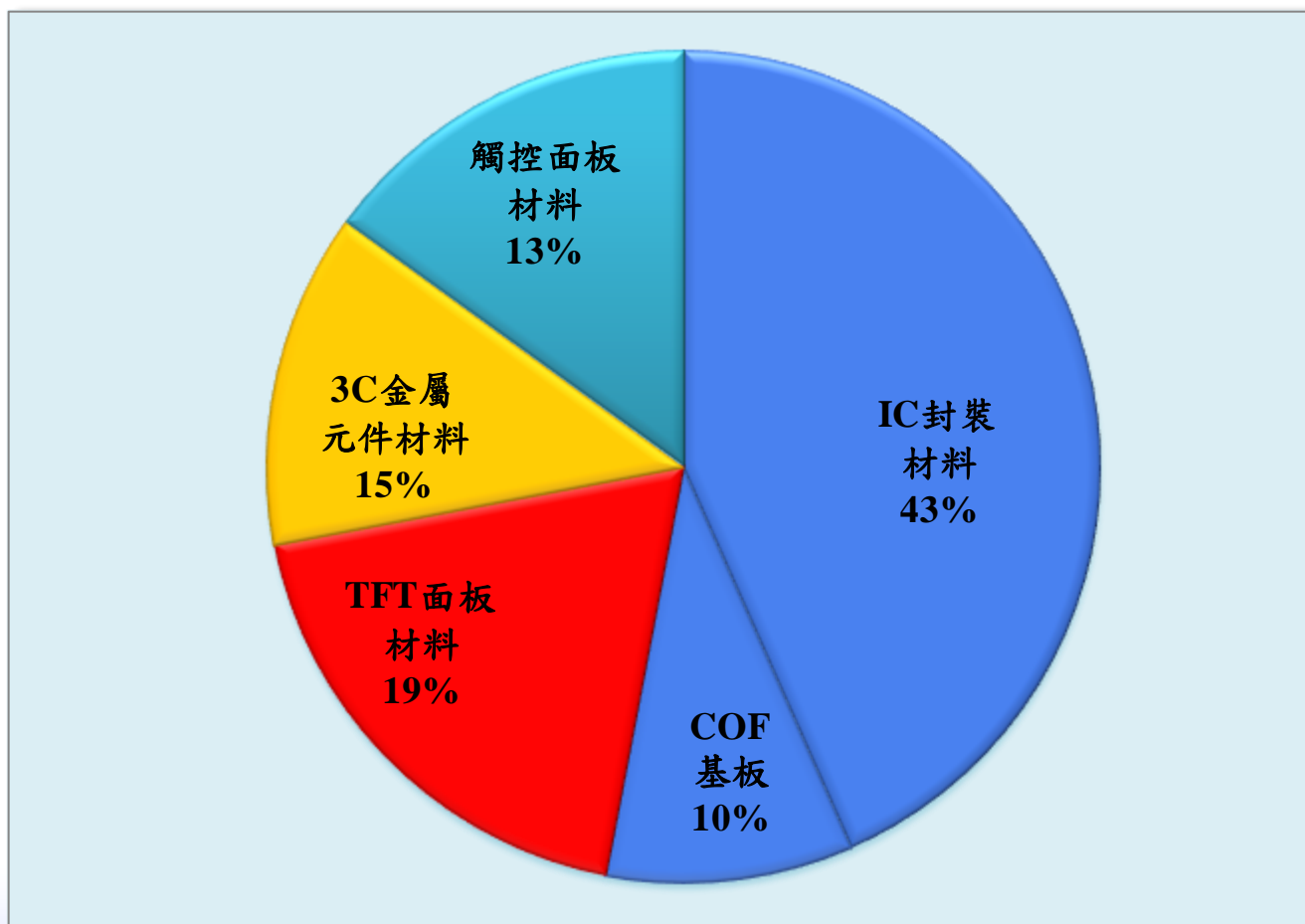
單位：NT百萬元

	2015年第二季		2014年第二季		變動率	2015年第一季		變動率
	金額	%	金額	%	%	金額	%	%
營業收入	3,852	100.0	4,464	100.0	(13.7)	4,078	100.0	(5.5)
銷貨成本	3,677	95.4	4,212	94.4	(12.7)	3,578	87.7	2.8
營業毛利	176	4.6	252	5.6	(30.3)	499	12.2	(64.8)
營業費用	352	9.1	254	5.7	38.6	262	6.4	34.4
營業淨利	(176)	(4.6)	(2)	(0.0)	-	237	5.8	-
營業外損益	914	23.7	24	0.5	3,725.7	25	0.6	3,555.1
稅前淨利	737	19.1	22	0.5	3,269.7	262	6.4	181.5
所得稅	57	1.5	(8)	(0.2)	-	38	0.9	50.0
停業單位損失	-	-	(10)	(0.2)	-	-	-	-
合併總淨利	680	17.7	30	0.7	2,176.0	224	5.5	203.8
歸屬母公司股東淨利	671		71		845.1	151		344.4
歸屬少數股權淨利	9		(51)		-	73		(87.7)
每股盈餘(元)-稅後	8.72		0.90			1.96		

2011~2015年H1資產負債表摘要(合併)

單位: NT百萬元	2011.12.31	2012.12.31 (IFRSs)	2013.12.31 (IFRSs)	2014.12.31 (IFRSs)	2015.6.30 (IFRSs)
現金及短期投資	1,692	1,509	1,144	1,241	1,953
應收帳款	3,642	4,130	4,778	5,037	3,910
流動資產	6,854	7,267	7,746	8,441	7,593
長期投資	584	735	1,116	1,125	2,499
流動負債	5,716	4,781	5,211	5,658	4,605
長期負債	732	1,096	1,417	2,184	1,793
權益總計	3,048	4,562	5,632	6,257	7,020
總資產	9,604	10,680	12,482	14,340	13,631
每股淨值(元)	40.59	53.93	56.15	59.30	69.42
流動比率	120%	152%	149%	149%	165%
負債比率	68%	57%	55%	56%	48%

2015年H1合併營收產品比重



三、主要轉投資公司概況

主要轉投資公司營收與獲利貢獻

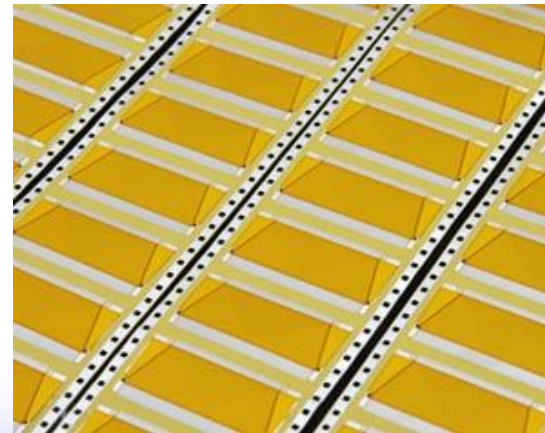
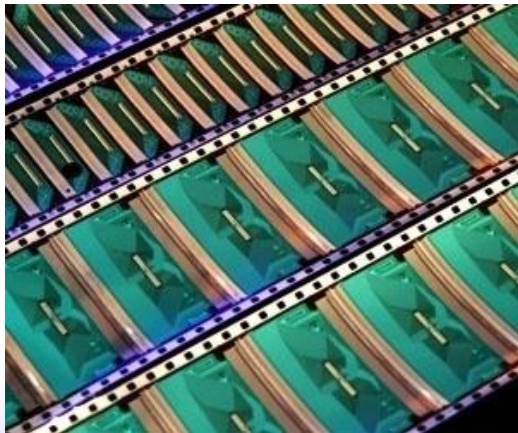
轉投資公司/新台幣億元	濠瑋		華德		長科		易華	
	2015年2Q	2015年1Q	2015年2Q	2015年1Q	2015年2Q	2015年1Q	2015年2Q	2015年1Q
營業年度								
營業收入	6.23	5.87	6.55	7.47	0.96	0.63	4.08	3.89
佔集團營收比重	16.2%	14.4%	17.0%	18.3%	2.5%	1.5%	10.6%	9.5%
稅後獲利	0.06	0.10	-0.15	0.30	0.10	0.07	0.39	1.56
長華認列獲利	0.03	0.10	-0.06	0.11	0.06	0.07	0.26	0.32
佔集團稅後獲利比重	0.45%	6.7%	-	7.5%	0.87%	4.3%	3.83%	21.2%
貢獻集團EPS(元)	0.04	0.13	-0.07	0.15	0.08	0.08	0.33	0.41

1. 易華電子股份有限公司

實收資本額：新台幣9.0億元

營收：2015年1~7月營收9.21億元

主要產品：COF(覆晶薄膜)、FPC(軟板)



主要客戶：國內外驅動IC設計廠商

主要競爭者：頡邦(欣寶)、南韓LG IT、Stemco、日本Shindo

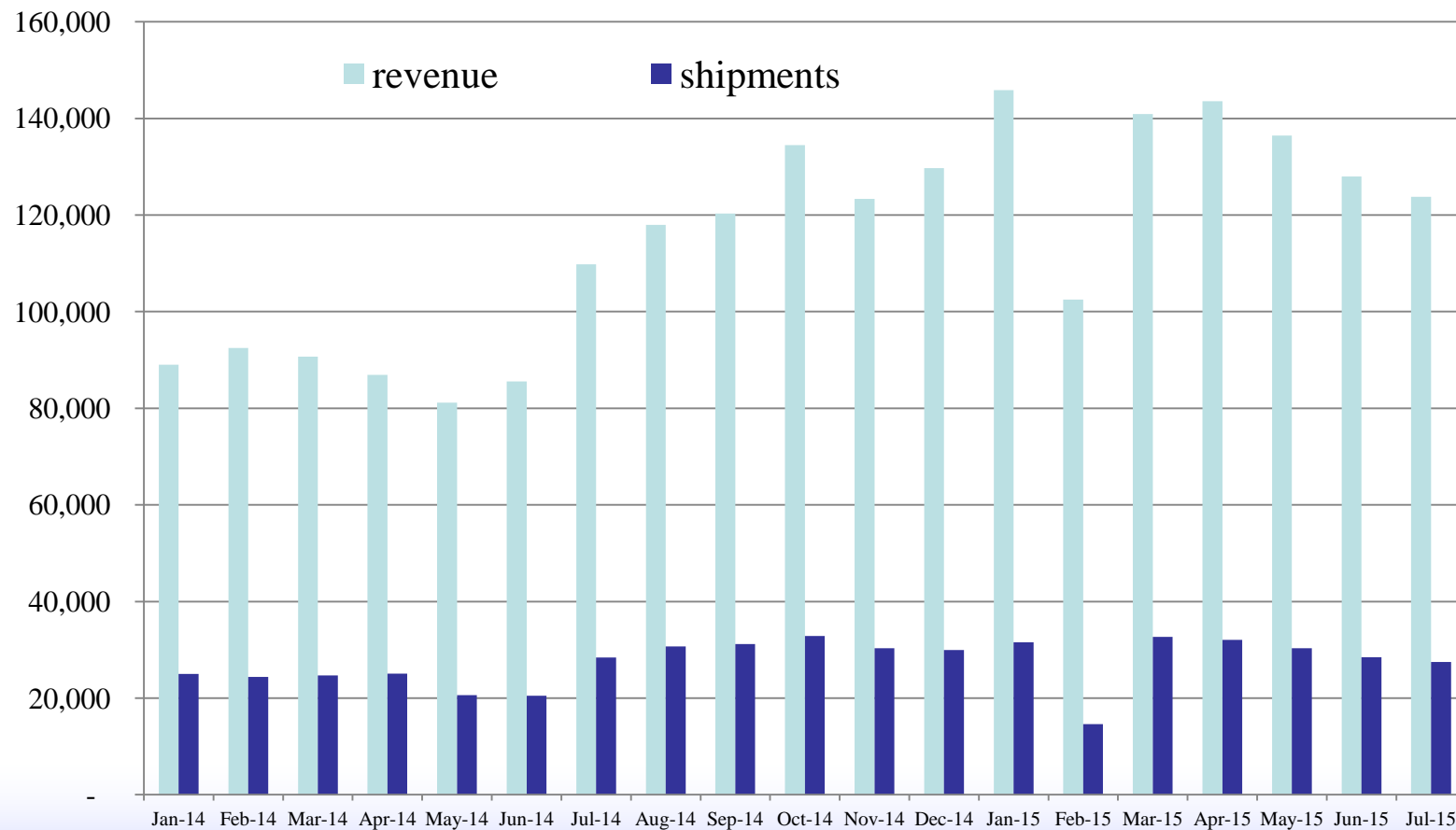
開發中產品：IC Thin Film Substrat、2-Metal COF

目前產能：36 KK /月 Semi Additive 製程 &
20 KK /月 New Etching 製程

未來成長動能：4K2K面板需求成長、新產品

月營收、出貨：

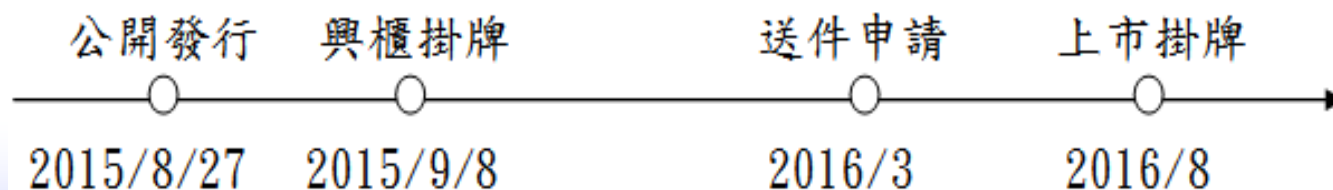
仟元、K



➤ 發展與展望：

- ① 積極發展2-Metal COF產品：整合印刷電路板、軟板及捲帶式軟性IC基板(COF)，成本將可大幅下降，預計2016年4Q量產出貨。
- ② 展望未來：中小尺寸面板因應解析度增加，驅動IC轉向採用COF封裝，加上4K2K大尺寸面板滲透率提高，驅動IC使用顆數大幅增加，未來COF需求成長可期。

➤ 上市規劃：



2. 長華科技股份有限公司(簡稱長華科，股票代號6548)

最新實收資本額：新台幣2.2億元

營收：2015年1~7月營收1.91億元，佔集團營收2.1%

主要產品：EMC L/F(熱固性環氧樹脂導線架, Epoxy Molding Compound Lead Frame)



產品優勢：“輕、薄、短、小” + “高功率” + “低成本”

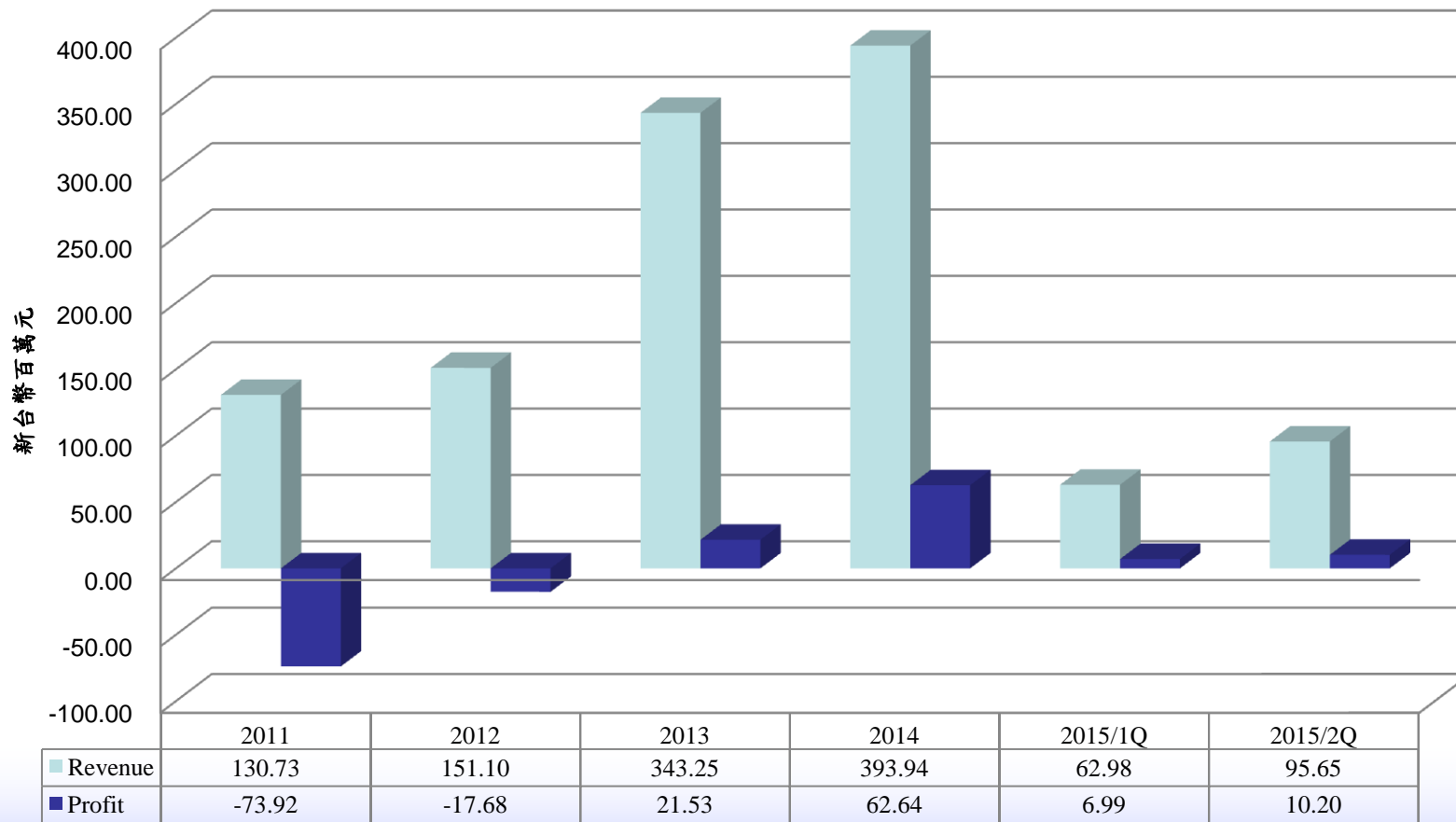
主要客戶：國內外LED封裝廠

市場競爭者：

- ① 國內：順德、一詮、復盛、健策、金利、特新、華震..
- ② 韓國：Samsung LED(in-house)、Seoul Semi.、Lumens、JungJin、Chamtech、Seoho、KET ..
- ③ 日本：Panasonic System Networks、Nichia (in-house)、YAMADA、TOPPAN..
- ④ 大陸：ASM、天電..

營收獲利：

長華科技股份有限公司

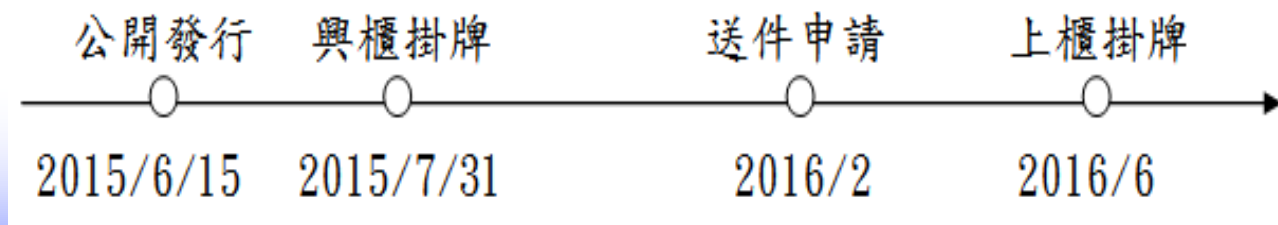


➤發展策略：

- ① 滿足目前市場(BLU,Lighting,Display,IR....)品質及成本需求
- ② 開發次世代產品、降低成本(已送客戶認證中)
- ③ 與國際級半導體大廠合作開發(環氧樹脂) EMC QFN導線架產品，提供新一代IC封裝用導線架材料

➤產能現況：單月產能80萬條

➤上櫃規劃：

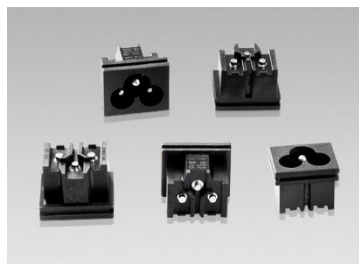


3. 濠瑋控股(開曼)公司

實收資本額：新台幣5.8億元

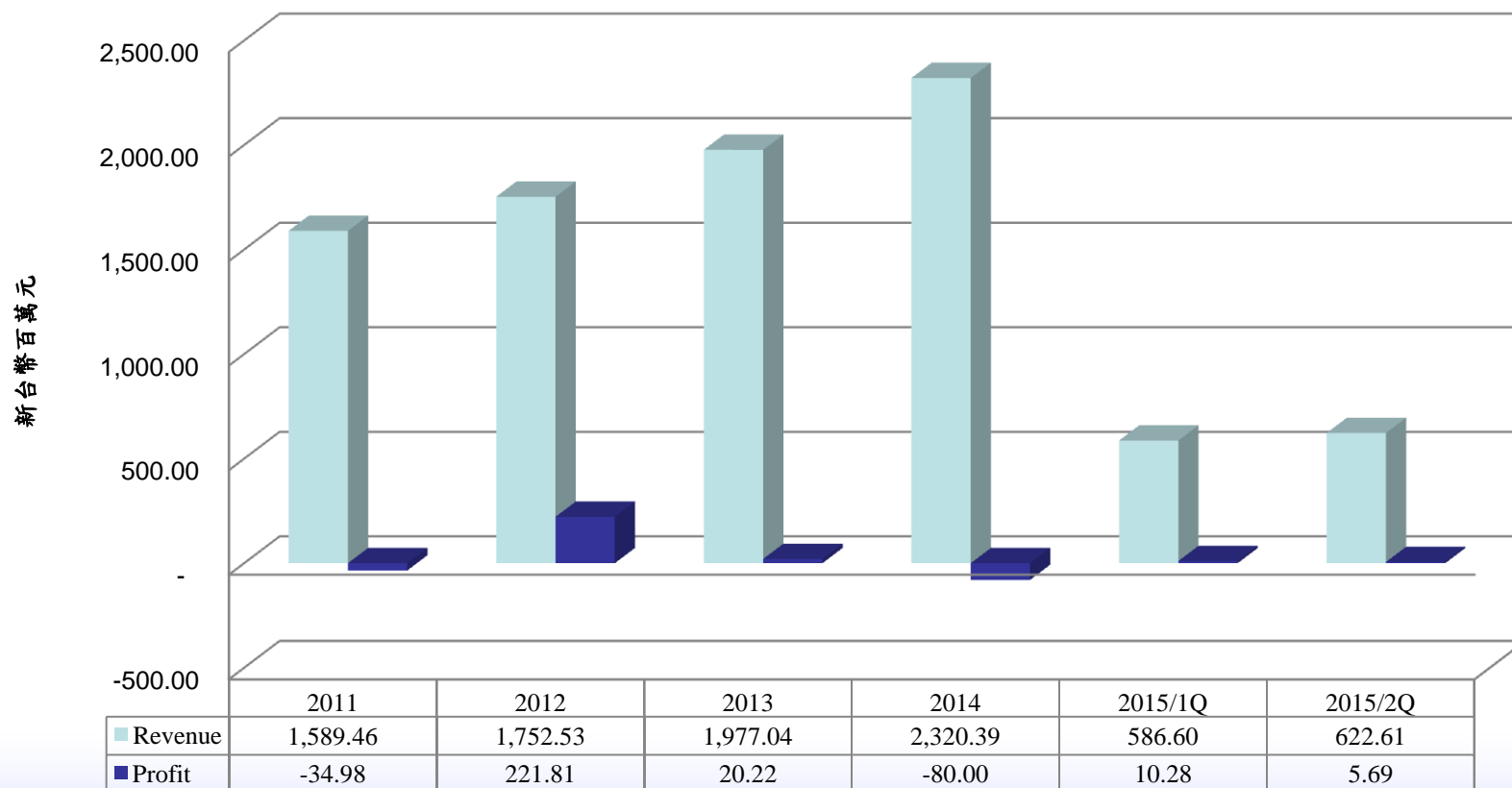
營收：2015年1~7月營收15.77億元，佔集團營收17.4%

主要產品：3C產品用之彈片、電源插頭/端子、耳機金屬導管、連接器、壓鑄產品



營收獲利：

濠瑋控股(開曼)有限公司



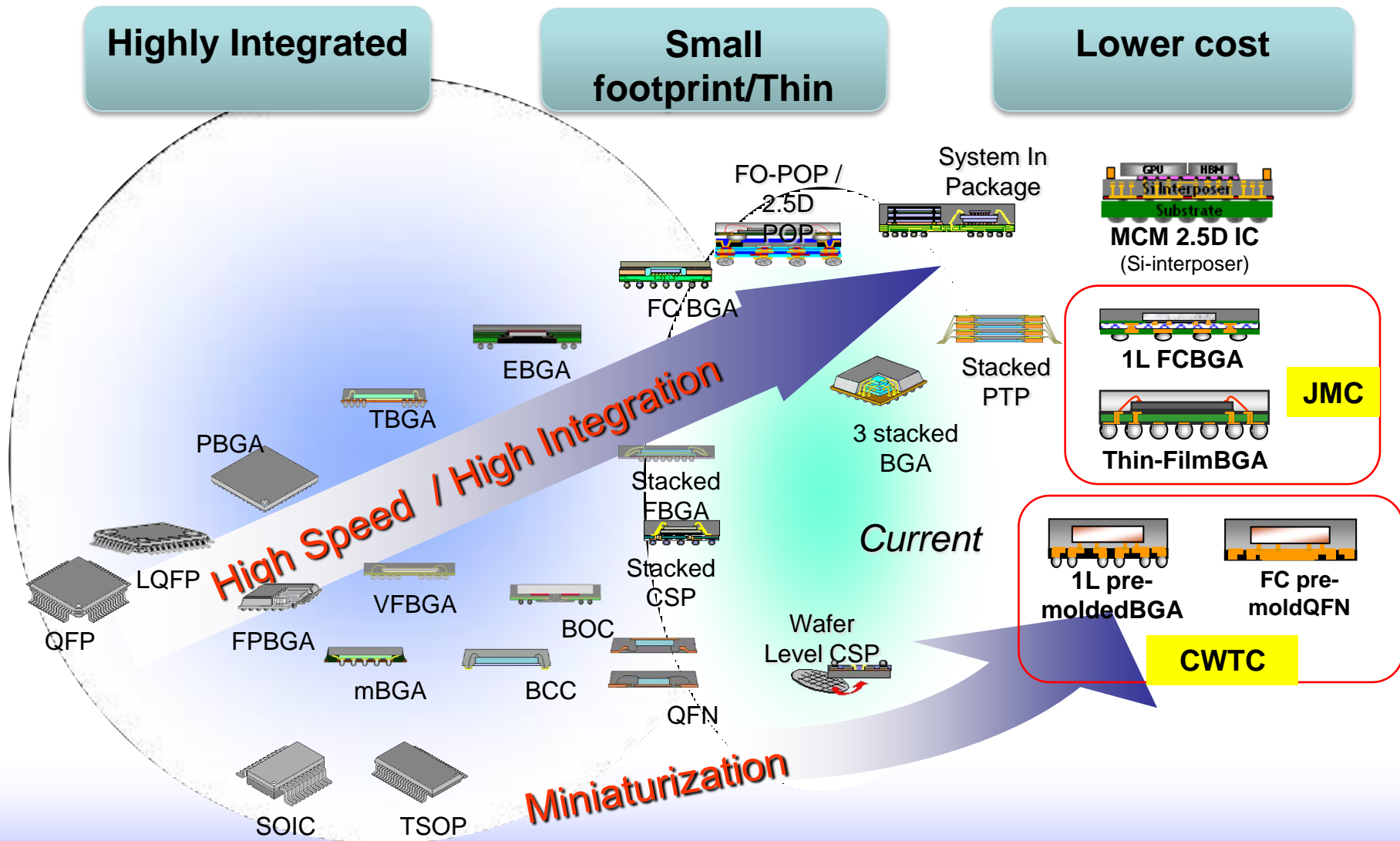
四、實施庫藏股買回

買回本公司股份

- 買回股份目的：維護公司信用及股東權益
- 買回股份總金額上限(元)：3,391,329,000
- 預定買回之期間：104/08/06~104/10/05
- 預定買回之數量(股)：3,000,000
- 買回區間價格(元)：59.00~133.00
- 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：3.90

五、中長期發展願景

IC封裝技術趨勢圖



成為全球半導體基板
重要供應商

發展方向

- 調整轉投資架構，聚焦半導體封裝材料領域。
- 長華長期耕耘半導體封裝材料，具備產品設計開發能力，借重轉投資公司長華科、易華電子之製造產能與研發技術，跨足新一代半導體基板材料。
- 運用集團兩岸三地營銷佈局，站穩半導體封裝材料市場領先地位。

七、Q & A